

삼성전자 DS부문

2025년 대학생 인턴 채용

당신의 성장이 세상의 혁신으로 이어지는 곳

오늘의 삼성전자 DS부문을 이룬 힘은 새로운 미래를 향한 구성원들의 끝없는 혁신에서 비롯되었습니다. 우리는 개개인의 성장과 발전이 곧 회사의 성장이며 더 나아가 새로운 세상으로 이끄는 힘이라고 확신합니다. 당신이 가슴 뛰는 일을 찾을 수 있는 곳, 당신의 상상이 혁신의 씨앗이 되는 곳,

서로를 존중하며 그 속에서 더 큰 성장을 이뤄내는 곳, 삼성전자 DS부문에서 당신의 내일을 만들어 보세요.



삼성전자 DS부문

2025년 대학생 인턴 채용공고

사업부	직무	모집전공	근무지
메모리 사업부	반도체공정설계	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	화성
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	화성, 평택, 천안
CTO_ 반도체 연구소	반도체공정설계	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	기흥,화성,평택
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	기흥,화성,평택
글로벌 제조&인프라 총괄	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	기흥, 화성, 평택, 천안
	인프라기술 (건설/Facility/전기)	전기전자(HW), 건축, 토목, 재료/금속, 화학/화공, 기계, 산공, 환경/안전, 수학, 통계(이공), 이공기타	기흥, 화성, 평택, 천안, 온양
TSP총괄	평가및분석	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 산공, 수학, 통계(이공), 이공기타	천안, 온양
	반도체공정기술	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 물리, 이공기타	천안, 온양
	패키지개발	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계, 이공기타	온양, 화성
AI센터	신호및시스템설계	산공, 전산/컴퓨터, 전기전자(HW), 기계, 물리, 수학, 통계(이공), 이공기타	기흥, 화성, 평택, 천안, 온양
	SW개발	전산/컴퓨터, 전기전자(SW), 산공, 기계, 물리, 수학, 통계(이공), 이공기타	기흥, 화성, 평택, 천안, 온양
	기구개발	전기전자(HW), 기계, 전산/컴퓨터, 산공, 이공기타	기흥, 화성, 평택, 천안, 온양

메모리 사업부

최첨단 기술을 이용한 DRAM/NAND/Solution 개발을 통해 세상의 모든 Data를 담을 수 있는 세계 최고의 메모리 회사

메모리사업부 (Memory Business)

• 직무: 반도체공정설계

• 근무지:경기도 화성

메모리 반도체 제품의 모든 공정 프로세스를 설계하고, 제품의 성능, 특성 및 품질 확보를 위한 최적의 소자 / Layout / Mask를 개발하는 직무

- 공정 프로세스 설계
 - 최적 공정 조건 개발 및 소자의 물리적 특성 설계
 - 제품 요구 성능과 품질, 양산성을 확보하기 위한 공정 설계 및 구현
 - 취약 공정 개선을 통한 안정적 수율 확보 및 공정 최적화
 - 소자 / 공정 특성을 활용한 양산 제품 검증
- 소자 개발 및 특성 분석
 - 제품 요구 성능과 품질을 확보하기 위한 소자 설계
 - 제품 양산성 확보를 위한 소자 특성 및 신뢰성 향상 방안 연구
 - 시뮬레이션을 이용한 소자 특성 예측 및 불량 분석
 - 분석 장비와 통계적 / 물리적 분석 방법을 활용한 소자특성 분석
 - 소자 Core 기술 개발
- Layout Architecture
 - 회로설계를 기반으로 한 제품 공정별 최적 Layout 및 Mask 설계
 - 최적화된 Pattern구현을 위해 Mask 기획부터 출고까지의 프로세스 수립/추진
 - Mask 제작 관련 내 / 외부 고객의 요구사항 분석 및 개선
 - 차세대 공정개발에서 발생할 위험요인을 감소시키기 위한 Mask 변경점 관리
- 수율 향상 및 불량 분석
 - 양산 제품의 공정 프로세스 결정 및 제품 생산의 기준 제시
 - 공정 기술 조건, 제품 특성, 원가, 수율 등 제품개발 / 생산활동 제반 연구
 - 제품 신뢰성 및 품질 분석 (WF & PKG Level)
 - 불량 분석 방법론 개발 및 데이터 분석 시스템 개발

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자기학, 반도체소자, 반도체공학, 기초전자회로 등

• 재료/금속

반도체 재료 및 소자, 재료공학개론, 결정구조, 재료물성 등

• 화학/화공

반도체집적공정, 유기 / 무기 화학, 물리화학 등

기계

고체역학, 유체역학, 열역학, 동역학 등

• 물리

반도체물리, 고체의 성질, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

Requirements

- 반도체 기본 동작원리, 공정개발 등 반도체 개발의 공정프로세스 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 단위 공정, Device physics 등 반도체 소자 및 공정 관련 전공지식 보유자
- 반도체 소자의 물리적/재료화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- 메모리 제품(DRAM, Flash memory 등)의 동작 원리와 구조를 이해하고 제품의 성능, 품질 개선에 필요한 직무지식 보유자
- 빅데이터 분석 역량 및 통계학 관련 전공지식 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Transistor 관련 (물리전자, 고체전자물리) 분석 유경험자
- Data Science 관련 Python, Machine Learning, Big Data, 통계 및 산술/회귀 분석 등 유경험자

- 반도체 제품의 공정 프로세스 설계부터 개선까지의 과정을 거쳐 공정 전반에 아우르는 지식 및 반도체역량을 배양할 수 있습니다.
- 최적 공정 조건 개발 및 소자 설계를 통해 반도체 소자 전문가로 성장할 수 있습니다.

메모리사업부 (Memory Business)

• 직무: 반도체공정기술

• 근무지: 경기도 화성, 평택, 충청남도 천안

반도체 공학 지식을 바탕으로 8대 공정기술, 기반기술을 연구/개발하여 생산성과 수율을 향상시키는 직무

- 8대 공정기술 개발 및 생산관리
 - 반도체 각 공정기술(Photo, Etch, Clean, CMP, Diffusion, IMP, Metal, CVD)의 개발 및 고도화
 - 신제품 양산을 위한 공정 최적화
 - 수율 / 품질 향상을 위한 불량 해결 및 공정 조건 표준화
 - 공정별 측정된 데이터의 정기 모니터링을 통한 생산 관리 및 품질 관리
- Defect(불량)개선 Engineering
 - 제품에서 발생하는 불량의 구조적, 물질적 특성 분석
 - Defect 발생원인 규명 및 개선 활동
- 공정 기반기술 연구
 - 계측 공정 개선을 통한 측정 결과 신뢰성 향상
 - 소자 구조 및 계면반응 분석으로 제품 개발 및 품질 향상
 - 양산 소재 품질 개선, 차세대 소재 확보, 공정한계극복Solution제공
 - 양산 소재 품질 관리 및 사용 공정 최적화 통한 생산성 향상 및 효율 극대화
 - 차세대 분석기술 확보 (신규 분석법 개발, Simulation 기법 등)
- 공정 / 설비 문제 분석 및 자동화 시스템 구현
 - 분석 Tool을 활용한 공정 / 설비 문제 원인 분석 및 해결
 - 빅데이터 분석을 활용한 공정 / 설비 자동화 시스템 구축 및 최적화

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

반도체소자, 전자기학, 반도체집적공정, 기초전자회로 등

• 재료/금속

반도체공정, 재료공학개론, 재료물리화학, 재료물성 등

• 화학/화공

반도체공정, 유기/무기화학, 물리화학 등

기계

고체역학, 메카트로닉스, 열역학, 동역학, 정역학, 유체역학 등

• 물리

반도체물리, 고체물리, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

Requirements

- 반도체 기본 동작원리, 공정개발 등 반도체 개발의 공정기술 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 소자의 물리적 / 재료화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- 빅데이터 분석 역량 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Big Data의 통계적 Tool 활용 가능자(R,Python 등)

- 공정 엔지니어로서 공정 전반의 연구 및 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 공정 최적화와 품질 개선 활동을 통해 공정 전문가로 성장할 수 있습니다.

CTO_반도체연구소

미래 기술의 시작점이자 차세대 반도체 개발의 중심!

CTO_반도체연구소(Semiconductor R&D Center)

- 직무: 반도체공정설계
- 근무지:경기도기흥,화성,평택

차세대 소자/공정/Package연구와 공정 설계를 통해 첨단 반도체 제품을 개발하는 직무

- Process Integration
 - 메모리 제품(DRAM, Flash, New Memory 등) 및 시스템 반도체(Logic, CIS 등), Package제품의 개발
 - 차세대 Memory/Logic/CIS/Package 등 Architecture/Structure/Integration 연구
 - 제품별 Line Data를 활용한 수율 예측 및 개선 방안 도출
- Device Analysis
 - Transistor, Cell Design 등 차세대 반도체 제품 소자 개발
 - 반도체 소자의 특성 예측, 측정, 데이터 분석을 통한 소자 특성 개선
 - 소자 동작 모델링 및 불량 분석을 통한 성능 및 수율 개선
- Package Design
 - Memory, System 반도체 Package설계
 - 고집적, 고성능 Package 구조 개발(V-NAND, Server용 DRAM 등)

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자회로, 전자기학, Device physics, VLSI design 등

• 재료/금속

재료공학원리, 재료물리화학, 재료공학개론, 분자전자재료, 재료물성 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

기계

고체역학, 열역학, 정역학, 동역학, 유체역학, 기계 진동학 등

• 물리

전자기학, 양자역학, 광학, 고체물리학, 반도체물리, 플라즈마물리학 등

Requirements

- 전기전자, 재료, 물성, 화학, 회로, 소자 및 물리 등 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 단위 공정 이해, 회로 및 소자 특성, 물성 및 화학 분석 원리, 전기전자 재료 특성 및 물성 등 반도체 설비 관련 경험자

Pluses

- 컴퓨터 프로그래밍 언어를 통한 개발, 데이터 분석 및 시뮬레이션 역량/경험 보유자
- 직무와 연관된 논문 작성 및 특허 출원 이력 보유자
- 해외 연구소/설비, 소재 협력사와 커뮤니케이션 가능한 수준의 외국어 회화 역량 보유자

- 반도체 제품 개발 전반을 경험하여 해당 제품 소자 및 Package 개발을 주도하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 각 소자별 선행 기술과 차세대 Package 기술에 대한 연구/개발을 통해 반도체의 미래 기술 전문가로 성장할 수 있습니다.

CTO_반도체연구소(Semiconductor R&D Center)

• 직무: 반도체공정기술

• 근무지:경기도기흥,화성,평택

차세대 공정/소재/Package/Mask를 연구하여 첨단 반도체의 공정 최적화를 구현하는 직무

Role

• 공정개발

- 제품개발을 위한 반도체 8대 선행 공정 및 차세대 Package 기술 확보 및 고도화
- 신물질 및 신개념 차세대 반도체 소자 구현을 위한 신공정 기술 개발
- Package 단위 공정(RDL, PKG조립 공정 등) 개발
- Module별 계측 Data 모니터링을 통한 공정관리
- 개발 방법론 및 프로세스 개선을 위한 요소기술 개발
- 신규 Precursor/차세대 반도체 및 Package의 소재 개발

• 분석기술

- Optic & E-beam등을 이용한 Defect Inspection 기술 개발
- Defect 환경 영향성 분석 및 Memory, Logic, Package 제품의 물성 분석
- Big Data 기반 생산 정보를 활용한 반도체 제조 공정, 설비, 환경 최적화

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자회로, 전자기학, Device physics, VLSI design 등

• 재료/금속

재료공학원리, 재료물리화학, 재료공학개론, 분자전자재료, 재료물성 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

기계

고체역학, 열역학, 정역학, 동역학, 유체역학, 기계 진동학 등

• 물리

전자기학, 양자역학, 광학, 고체물리학, 반도체물리, 플라즈마물리학 등

Requirements

- 전기전자, 재료, 물성, 화학, 회로, 소자 및 물리 등 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 단위 공정 이해, 회로 및 소자 특성, 물성 및 화학 분석 원리, 전기전자 재료 특성 및 물성 등 반도체 설비 관련 경험자, Biq Data 활용 역량 보유자

Pluses

- 컴퓨터 프로그래밍 언어를 통한 개발, 데이터 분석 및 시뮬레이션 역량/경험 보유자
- 직무와 연관된 논문 작성 및 특허 출원 이력 보유자
- 해외 연구소/설비, 소재 협력사와 커뮤니케이션 가능한 수준의 외국어 회화 역량 보유자

- 반도체 8대 공정 및 Package의 선행 개발 경험을 통해 미래 공정을 선도하는 최고 공정 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 소재, 설비, 시뮬레이션 등 반도체 공정기술과 관련된 여러 분야와의 협업을 통해 저변을 넓힐 수 있습니다.



미래지향적 · 친환경 FAB을 위한 인프라/제조 공통 요소 기술 조직



글로벌 제조&인프라총괄 (Global Manufacturing & Infra Technology)

- 직무: 반도체공정기술
- 근무지: 경기도 기흥, 화성, 평택, 충청남도 천안

반도체 공학 지식을 바탕으로 검사·계측/소재/분석 기술 연구하여 생산성과 수율 향상시키는 직무

- 검사(Inspection)·계측(Metrology)기술 개발 및 생산 관리
 - 측정된 검사, 계측 데이터 모니터링을 통한 품질 관리, 항상성 유지관리
 - 제품 모니터링을 위한 검사, 계측 기술 개발 및 고도화
 - 신제품 양산을 위한 검사, 계측 조건 최적화 및 생산성 향상
- 반도체 소재 개발 및 수율 확보
 - 반도체 공정 관련 소재 개발 & 품질 관리 및 수율 확보
 - 대내외 협업을 통한 소재 및 소재 기술 IP 확보
- 불량 개선 및 수율 향상 및 품질 관리
 - 연구/개발/양산/출하 각 단계에서 발생하는 불량 검출 및 개선
 - 다양한 분석 설비 활용하여 불량 원인 분석 및 모델링을 통한 불량 개선
 - 불량 관리 인자 발굴 및 효율적인 모니터링 기술 개발
- 비정형 System 개발 및 Data 분석을 통한 업무 효율화
 - 통계·AI 기반 Data 분석
 - 자동화 시스템 및 소재 이상 감지 시스템 구축
 - 생산량 극대화를 위한 생산 제어 시스템 구축

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

반도체소자, 반도체공정, 회로이론, 전자기학, 반도체집적공정, 기초전자회로 등

• 재료/금속

반도체공정, 재료공학개론, 재료물리화학, 재료물성, 결정학, 강도학 등

• 화학/화공

반도체공정, 유기/무기화학, 물리화학, 계면화학, 분석화학 등

기계

고체역학, 메카트로닉스, 열역학, 동역학, 정역학, 유체역학 등

• 물리

반도체물리, 고체물리, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

Requirements

- 반도체 소자/공정/소재에 대한 기본적인 지식 보유자
- 반도체 제품의 이해 및 물성/소재/설비에 대한 역량 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- Data 분석/통계 및 프로그래밍 (Python, Java, C, SQL 등) 가능한 자
- 계측/분석/검사 설비(SEM, TEM 등) 활용 경험 보유자
- 고객 품질 대응 이해 및 품질 자격증 보유
- 어학 (영어/중국어/일어) 능력

- 검사, 계측 모니터링 기술 개발 및 불량 개선에 기여하는 공정 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 제품 개발부터 양산까지의 분석 솔루션을 제공하며, 평가 및 분석 역량을 배양할 수 있습니다.
- 신뢰성, 품질 보증, 고객 지원 관련 역량을 보유한 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 공정에 사용되는 소재에 대한 품질 관리 및 연구 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.

글로벌 제조&인프라총괄 (Global Manufacturing & Infra Technology)

- 직무:인프라기술(건설/Facility/전기)
- 근무지: 경기도 기흥, 화성, 평택, 충청남도 천안, 온양

반도체 생산 인프라 건설 및 미래 건설 기술 연구/기획, 당사 전력 공급과 반도체 생산에 필요한 초순수, 공조/냉동보일러 등 Utility를 안전하고 안정적으로 공급하기 위하여 시스템 기획/설계, 기술 개발, 유지보수 등을 하는 직무

Role

• 건설 기술

- 반도체 FAB 기획/설계: 미래 FAB Concept 및 FAB 기술개발, 최적설계 적용, 신규단지 개발 기획, 설계, 구조설계 및 BIM(클라우드 기반의 3D 설계 플랫폼 구축)
- 건설 품질 관리: 품질관리 시스템화 및 검측 기준 CQI 제/개정
- 건설 PJT 시공/설계 관리: 건설 프로젝트 Shop설계 및 신공법, 모듈화 시공 현장 관리
- 건설 공정 관리: PJT Master Schedule 수립 및 실행력 관리, 표준공정관리 체계 구축
- 건설 안전: 건설 안전 규정 검토 및 대내외 법규대응 업무 수행

Facility 기술

- 시스템 설계/시공 : Facility/Utility 시스템(HVAC, UPW, 배기, Bulk Gas, 폐수 등) 요소별 조건을 파악하여 설계/시공 및 신기술 개발을 통한 고효율 인프라 시스템 구축
- Facility/Utility 운영: 공급 품질 관리, 부하율 관리, 불합리 발굴/조치 등 개선 활동을 통해 생산 공정에 필요한 Facility/Utility(HVAC, UPW, 배기, Bulk Gas, 폐수 등)의 최적 조건 운영
- Infra Risk Prevention: 반도체 인프라 계통의 비정상 발생 대응 및 2차 사고 예방 활동
- · 배관/설비 RBI 진단, 신기술/신공법 동향 연구, 비정상 원인 분석, 시공 표준 제/개정

• 전기 기술

- 전력 계통 운영: 무정전 전원 공급을 위한 안정적인 계통 운영 및 전기 설비 관리, Relay Coordination, 계통 감시, 비상 대응
- 전기 공사 및 유지보수: 신규 라인 증설, 설비별 전원공급, 신뢰성 Test, 전기 설비 보전
- 생산 설비 전기 인프라 구축 : 생산 설비 전원 공급, 전원 Spec 표준화
- 안전 관리 및 에너지 절감: 공사/유지보수/점검 시 전기 안전 관리, 에너지 절감 및 효율화
- 전기 품질 관리: 전기 설비 표준화, 신기술 발굴/적용, 고장 진단 기술 개발

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전기공학실험, 전력공학, 전기기기, 제어공학, 전력전자, 회로이론 등

• 건축/토목

구조역학, 재료역학, 건축설계, 건축법, 건축설비, 건축재료공학, 강구조역학 등

• 재료/금속

재료공학원리, 재료물리화학, 재료공학개론, 분자전자재료, 재료물성 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

기계

동역학, 열역학, 유체역학, 물리화학, 열 및 물질전달 등

• 산업공학

데이터마이닝, 데이터분석, 통계응용 등

• 환경/안전

환경안전공학, 기계설비안전, 화학공정안전, 위험성평가, 폐수처리공학, 대기공학, 설비진단기술 등

• 수학/통계

확률의 개념 및 응용, 수리통계, 수치해석, 선형대수학, 데이터과학 등

Requirements

- 전기전자, 건축/토목, 재료/금속, 화학/화공, 기계, 산업공학, 환경/안전, 수학/통계 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 기술적 이론과 분석적 사고를 바탕으로 공학적인 문제 해결이 가능한 자

Pluses

- 해당 전공 관련 기사 및 기술사 자격증 취득자
- 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
- 해외 법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유자

- 국내외 삼성전자 DS 사업장 및 건물(FAB, 사무환경 등)을 기획/설계/시공하는 등 반도체 생산에 필요한 최상의 FAB 건설 인프라를 구축합니다.
- 반도체 생산에 필요한 Facility/Utility(HVAC, UPW, 배기, Bulk Gas 등)를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 유지보수부터 기술 개발까지 전 프로세스를 담당하며 인프라 엔지니어로 성장할 수 있습니다.
- 반도체 생산에 필요한 전기를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 유지보수부터 기술 개발까지 전 프로세스를 담당하며 인프라 엔지니어로 성장할 수 있습니다.

TSP총괄

반도체 가치를 극대화하는 패키지의 힘!

TSP 총괄 (Test and System PKG)

• 직무:평가및분석

• 근무지:충청남도 천안, 온양

반도체 Package 불량 발생 시, 발생 원인을 분석하여 재발되지 않도록 방안을 수립하고, 반도체 공정 설비와 계측기, Test 설비에서 발생하는 Big Data를 활용하여 이상점 감지를 통해 불량 발생을 사전에 예측하고 수율을 향상시키는 직무 (품질 및 수율 관리, 불량 분석) 공정 결과 측정을 위한 계측 설비와 알고리즘을 개발하고, 불량 발생 시 비파괴(X-ray, CSAM, CT) 분석과 파괴 분석(Cross Section, Decap)을 통해 원인 Define

- 신제품 품질 Risk 분석
 - 설계/소재/공정성 개발 단계 품질 Risk 사전 검증
 - 제품 Design Rule 개선 및 공정 마진 평가
 - 신제품 신뢰성 평가 및 분석
- 양산 품질 개선
 - 공정 변경점 및 산포 관리를 통해 품질 위험요소 관리/개선
 - 품질 Data 분류, Grouping 및 A/I 기법 활용을 통한 유효 인자 감지
 - 공정 모니터링을 위한 통계적 샘플 계측 방법 제시
 - 품질 시스템 구축 및 시스템 개선
- 수율 개선 및 불량 분석
 - 제품 양산성 관리 및 수율 개선
 - 반도체 Package의 비파괴/파괴(전기적/물리적) 분석을 진행하여 불량의 원인 분석
 - 제품 설계, 공정, 고객의 관점에서 특성을 평가하여 불량 원인 규명
 - 분석한 제품/공정/소재 불량의 원인에 대한 Solution 도출 및 개선사항 관리
 - Big Data 분석 및 통계 모델링을 통한 불량 예측 및 예방

• 계측기술 개발

- 공정 결과 자동 측정을 위한 계측설비 개발
- 자동화 공정 계측(Measurement)&검사(Inspection) 기술 개발 및 개선 연구

• Package 소재 입고 품질 관리

- 반도체 Package용 유기/무기/고분자 소재 개발 및 양산 소재의 품질 관리 (Film, EMC, Metal, Substrate, Capacitor 등)
- 소재사 CoA(Certificate of Analysis) data 분석 및 항목 최적화
- 소재사 변경점 및 CoA 산포 관리를 통한 위험요소 관리/개선
- 불량 원인 및 소재사 R/M/F Parameter에 대한 동질성 분석 (R: Raw Material, M: Process Monitoring, F: Final Product)

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

전자회로, 회로이론, 전기전자회로, 디지털시스템설계 및 실험, 논리회로, 컴퓨터프로그래밍, 컴퓨터구조, 데이터 구조 및 알고리즘, 신호 및 시스템, 디지털 신호처리, Microwave/RF Engineering, 데이터구조 등

재료/금속

반도체과학, 재료역학, 금속재료학, 최신반도체 재료 및 소자 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

기계

열역학, 유체역학, 열전달, 컴퓨터시뮬레이션과 설계, 고체역학, 동역학, 기계공학실험, 기구학, 기계요소설계, 센서 개론, 설계 제작 실습 등

• 산업공학

데이터마이닝, 데이터분석, 통계응용 등

• 수학/통계

확률의 개념 및 응용, 수리통계, 수치해석, 선형대수학, 데이터과학 등

Requirements

- 전기/전자/논리 회로 이해 능력 및 Simulation 기초
- 프로그래밍 언어(C/C++/Verilog, Java, R, Python 등) 및 알고리즘 문제 해결 역량 보유자
- 기구/모터/실린더 등 요소 기술에 대하여 이해하고 적용 가능한 자
- CAD를 이해하고 이에 맞는 Simulation 구현이 가능한 자
- 다양한 분석장비(SEM, FTIR, RAMAN, IC, XPS 등)의 사용 경험 및 활용이 가능한 자

Pluses

- 품질 직무에 대한 기본적인 지식 보유자 (품질 공학, 환경안전, PL(Product Liability), SPC, 생산관리, Test Engineering, Big Data 해석)
- 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 활용한 프로젝트 수행 경험 보유자

- Package 제품의 공정 모니터링, 수율, 품질 등 전체 프로세스 관리 및 Data 분석, 패키징 심화 분석 역량을 배양할 수 있습니다.
- 반도체 산업에서 패키징 Process에 대한 높은 이해도를 가질 수 있으며, 향후 Process Integration, Quality Management, Data Scientist, Defect Analyst 등 다양한 분야의 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 신 제품/소재/공정 개발 검증, 양산 품질 관리, 품질경영시스템, 제품 신뢰성 평가 및 고객 대응 기능 역량을 배양할 수 있습니다.
- 다양한 제품의 평가, Big 데이터 분석, 통계적 양산 관리, Audit 경험을 통해 패키징 관련 품질 전문가로 성장할 수 있습니다.

TSP 총괄 (Test and System PKG)

• 직무: 반도체공정기술

• 근무지: 충청남도 천안, 온양

Package조립 공정, Test공정과 관련된 기반기술을 연구/개발하여 불량률을 낮추고 생산성을 높이는 직무

[주요 제품] Chip Level Package 제품: V-NAND, LPDDR, μSSD, LEDoS 등 Advanced Package 제품: HBM, FoWLP, FoPLP, 2.5D 등

- Package 양산 공정 개선 및 생산성 향상
 - PKG 조립 공정(Back-Lap, Saw, CoW Bonding, Mold, Marking, Solder Ball Attach)별 불량률 개선 및 생산성 향상 기술/설비 개발
 - Test공정(MBT, Test, MVP) 불량률 개선 및 생산성 향상, Tester 설비 개발
 - 양산 제품의 품질/수율 향상을 위한 불량 분석/개선 및 공정 조건 표준화
 - 공정별 데이터 분석을 통한 양산 Process 최적화 및 품질 관리/개선
- 공정 기반기술 연구
 - Test/계측 Data 분석을 통한 불량 예방 및 측정 Data 신뢰성 향상
 - 공정에서 발생하는 불량 원인에 대한 물리적, 화학적 메커니즘 수립 및 개선 연구
 - 양산 소재 품질 관리 및 사용 공정 최적화 통한 생산성 향상 및 효율 극대화
 - 공정 효율 개선, 소재 변경 및 개선을 통한 제조원가 개선
- 공정설비 개조개선 및 신규 설비 개발
 - 양산 Data를 활용한 공정 최적화, 이상점 분석/개선, 자동화 시스템 구축
 - 데이터 분석을 활용한 공정/설비 자동화 시스템 구축 및 최적화

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

반도체소자, 전자회로, 전자기학, 반도체집적공정, 기초전자회로 등

재료/금속

반도체공정, 재료공학개론, 재료물리화학, 재료물성 등

• 화학/화공

반도체공정, 유기/무기화학, 물리화학 등

기계

고체역학, 메카트로닉스, 열역학, 동역학, 정역학, 유체역학 등

• 물리

반도체물리, 고체물리, 양자역학, 전자기학, 플라즈마 기초 등

Requirements

- 반도체 FAB공정, Package조립 공정, Test공정 등 반도체 공정기술 개선에 필요한 역량 보유자
- 반도체 FAB소재(Gas, Chemical, Metal), PKG 조립소재(Film, EMC, Wire, Under-Fill)의 물리적 / 재료 화학적 분석에 필요한 역량 보유자
- 데이터 분석 역량 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- 반도체 개발 관련 Tool (DC Analyzer, LCR Meter 등) 역량 보유자

- 세계 반도체 시장의 핵심 경쟁력인 패키징 각 공정의 공법, 공정 조건 개발 업무 능력 배양을 통해 Process Integration, Process Developer 전문가로 성장할 수 있습니다.
- Package 제품의 Wafer, Package, Test Process 품질/생산성 향상 업무 및 공정 기반기술 연구 역량을 배양할 수 있습니다.
- 발전하는 차세대 반도체 공정 연구/분석/개선 직무 경험을 바탕으로 Package 공정기술 전문가로 성장할 수 있습니다.
- 반도체 테스트 엔지니어로 테스트 프로그램 작성, 인터페이스 개발을 진행하며, 신제품 Test Solution을 제공할 수 있습니다.
- 공정/출하 시 발생하는 주요 불량인자들에 대해 분석하고 해결책을 적용하여 개선 할 수 있습니다.
- 반도체 설비의 컨셉 설계, 요소기술 개발, 설비 시스템 S/W, 통신 등 설비 표준화 플랫폼 개발의 전문가로 성장할 수 있습니다.

TSP 총괄 (Test and System PKG)

• 직무:패키지개발

• 근무지: 충청남도 온양, 경기도 화성

Chip Level Package의 설계, 제품/구조/소재 개발 및 Simulation과 첨단 제조 공정을 개발/최적화하고 제품 성능 극대화를 통해 첨단 반도체의 가치를 향상 [주요제품] Chip Level Package 제품: Mobile DRAM, SSD, MCP, UFS, DDI, Sensor등

Role

• Package 설계

- 첨단Memory/Logic 반도체의 Package 설계
- Chip과 Set Board간 신호, 전력 전송을 위한Package 설계
- Data Center, Mobile용 집적도 향상을 위한 Package 구조 설계

Simulation

- Electrical Simulation (Signal/Power Integrity, EMI, RFI 설계)
- Electrical/Thermal/Mechanical Simulation을 통한 Package 구조/소재/공정 최적화

Package 제품 개발

- Memory/Logic 등 Package 제품들의 적기 개발을 위해 개발 일정/진척 관리
- Package 최고 성능과 원가 경쟁력 확보를 위해 신기술 개발, 최적화된 공정 Process 구상 및 수율 관리/불량 분석

• 소재 개발

- 반도체 Package용 유기/무기/고분자 소재 개발 및 양산 소재의 품질 관리 (Film, EMC, Metal, Substrate 등)
- Consumable 소재 개발 및 최적화 (EMC, Substrate, DAF, PR소재 등)
- Package 특성/원가/품질 경쟁력 확보를 위한 차별화 소재, 소자, 회로기판 연구 개발
- 차세대 Fundamental 소재 연구 및 미래 핵심 소재 요소기술 개발

• 단위 공정 기술 개발

- Package 단위 공정(BL, Saw, WB, MOLD 등) 및 요소기술 개발 *PKG 조립 공정(Back-Lap, Saw, Bonding, Mold, Marking, Solder Ball Attach)
- 단위 공정의 생산성 향상, 품질 문제 분석 및 해결
- 신규 공정 기술 발굴, 적용 및 공정 표준화
- 원가 절감 및 Process 효율화

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

회로 이론, 전자기학, 반도체소자개론, 신호 및 시스템, 전기전자 회로 및 실험, 컴퓨터 구조, 자료구조개론, 알고리즘, 운영체제론, 시스템프로그래밍 등

• 재료/금속

재료공학 원리, 재료공학 개론, 재료역학, 재료열역학, 재료거동학, 금속재료학, 유기재료공학, 결정학개론, 재료상변태, 반도체 집적공정 등

• 화학/화공

유기/무기화학, 물리화학, 분석화학, 나노소재화학 등

기계

정역학, 동역학, 고체역학, 유체역학, 열역학, 기계진동학, 마이크로기전 시스템, 기계제품 설계, 마이크로 나노기계공학, 컴퓨터시뮬레이션과 설계, 고체역학, 열전달, 전산제도(설계/CAD프로그램), 기구학, 기계요소설계, 센서개론, 설계 실습 과목 등

Requirements

- 금속, 재료, 기계, 화학, 전기/전자 공학 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 반도체 설비, Tool, 금형의 구조와 동작 원리를 이해하고 활용이 가능한 자
- 다양한 분석장비(SEM, FTIR, RAMAN, IC, XPS 등)의 사용 경험 및 활용이 가능한 자
- 기구/모터/실린더 등 요소 기술에 대하여 이해하고 적용 가능한 자
- CAD를 이해하고 이에 맞는 Simulation 구현이 가능한 자

Pluses

- 반도체 Package 및 품질 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
- 반도체 Package공정 및 품질 관련 졸업논문 및 국내/외 저널 논문 보유자
- 반도체 Package 관련 Simulation Tool (ABAQUS, ANSYS, LS-Dyna 등) 역량 보유자
- SI/PI/Thermal/Mechanical Simulation Tool경험 보유자
- 기계적/열특성 분석, 성분 분석 등 다양한 분야의 분석 역량 보유자

- 반도체 산업에서 중요성이 부각되고 있는 Package의 설계, Simulation, 제품/구조/공정/소재를 개발하고 최적화 하는 전문 역량을 배양할 수 있습니다.
- PKG 제품에 대한 높은 이해도를 바탕으로 제품/공정/소재/기술 Engineer로서의 성장뿐만 아니라 고객 대응, 기획, 마케팅 등 다양한 분야의 전문가로 성장할 수 있습니다.

AI센터

반도체 비지니스의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 AI & IT 기술과 서비스를 제공하는 CIO 조직

AI센터 (AI Center)

- 직무:신호 및 시스템설계
- 근무지: 경기도 기흥, 화성, 평택, 충청남도 천안, 온양

Data 및 신기술(AI, ML 등)을 바탕으로 DS 부문의 IT 인프라/서비스 설계 및 개발을 통해 Autonomous Factory 구축을 목표로 연구 개발하는 직무

- Autonomous Factory 설계/구축
 - Autonomous Factory 향 Manufacturing Execution System 설계
 - 안정적인 시스템 유지를 위한 SRE(Site Reliability Engineering)
 - 설비/공정 품질 및 수율/품질 개선을 위한 시스템 설계
 - 검사/계측, 설비 환경 Data 분석 및 차세대 Data Pipeline 솔루션 설계
 - Safety 환경안전 & Smart Infra 시스템 설계 및 고도화
 - 가상 FAB Modeling & Simulation 통한 FAB Capa 및 실시간 이상 감지 설계
 - 업무 프로세스 기반 시스템 통합 설계 및 개발
- Digital Twin 기반의 Automation System 기획/구축/운영
 - DS부문 국내/외 제조라인 자동화 기획/설계
 - Autonomous Factory 향 반송/로봇 Platform 구축
 - 반도체 FAB 변동성 고려 설비배치 및 AHMS 최적 설계 Modeling
 - 안정적인 물류 제어 시스템 유지를 위한 SRE(Site Reliability Engineering)
 - 물류 Capa 검증 및 분석, 물류 Simulation을 통한 반송 최적화
 - 생산 환경 변화를 위한 물류 반송/저장 System 기획/설계
 - 반송/로봇 설비 이상감지진단 및 품질 관리

• Information Strategy 수립/운영

- DS부문 AI/IT 서비스 전략 및 정책 수립 및 Governance 체계 구축·강화
- EA 정보 최신화 및 DS IT 시스템/비용 최적화
- DS IT Resource Governance 체계화 및 운영 효율화
- DS 연구개발 관리 체계(N-PLM) 구축
- Al Acceleration 프로그램 설계 및 사업부 맞춤형 지원 서비스 제공
- Al Literacy 프로그램 기획 및 운영
- AI 서비스 Value Management 체계 구축

● Data/DevOps/Knowledge Service 기획/구축/운영

- AI/ML/DL 모델을 활용한 서비스, 검색, 챗봇, Q&A 등 사내 서비스 인프라 기획/구축/운영
- 학습용 Data 전처리 및 Data Pipeline 기획/구축/운영
- DevOps/협업 Tool 구축/운영 및 Build/CI/CD 인프라 기획/구축/운영
- Data Platform/Data Lake/DW 및 Data IT Infra 설계/구축/운영
- Self-Analytics 도구, 데이터 병렬 분산 처리 도구 및 DBaaS 기획/구축/운영
- Data Governance(운영/보안/메타데이터/표준화/품질/기준정보) 및 Governance System 기획/구축/운영
- 개념/논리 Data Modeling 및 대용량 Data Processing System 기획/구축/운영

• IT Infra Structure 설계/구축/운영

- Server, Storage, Network Infra 설계/구축 및 운영기술 고도화
- Supercomputing & AI(ML/DL) Infra 및 High Performance Computing Infra 설계/구축/운영
- Computing Architecture 연구/개발
- 차세대 Data Center 구축, 고집적/고효율 Facility 구축/운영 및 효율화
- Cloud(Private/Public/Hybrid) Enterprise Architecture 설계
- OA/IAM/협업서비스 등 Modern Workplace 구축/운영

MIS(Management Information System) 기획/구축/운영

- DS부문의 효율적인 경영을 위한 경영정보 시스템 기획/구축/운영 (Business Intelligence)
- ERP, PLM, CRM, SCM, SRM, EHS 등 분야별 업무 프로세스 및 Data 분석, 취약점 진단
- IT시스템 Solution 및 전략 수립(PI Consulting, Process Innovation)
- MIS Application/Architecture 및 HW/SW 관리/운영/개선/최적화(SM. System Management)
- Web/Mobile Platform을 활용한 시스템 Architecture(Business, UX, Data, I/F) 설계 및 IT프로젝트(SI. System Integration) 추진/관리(PMO)
- MIS SRE(Site Reliability Engineering) 기준설계/이상감지

Recommended Subject

• 산업공학

데이터관리와 분석, 프로그래밍언어, 실험계획법, 정보산업공학, SCM, 경영과학, 경영전략, 프로젝트관리, 품질경영, 경영정보시스템 등

• 전산/컴퓨터

컴퓨터구조, 프로그래밍언어, 컴퓨터프로그래밍, 소프트웨어공학, 알고리즘, 운영체제, 데이터분석, 데이터마이닝, 머신러닝, AI, 빅데이터 등

• 전기전자(HW)

통신이론, 네트워크 설계, 데이터구조, 프로그래밍 등

기계

진동학, 동역학, 기계제품설계, 시스템제어이론, 기계설계학, 기계시스템 설계, 열역학, 열전달, 유체역학, 공조/냉동 등

• 물리

전자계측 및 실습, 전산물리 등

• 수학/통계

확률 개념 및 응용, 공업수학, 데이터마이닝, 통계분석, 회귀분석, 선형대수학 등

Requirements

- 데이터 분석 및 통신 방식을 이해하고 신기술에 대한 관심과 이해도를 보유한 자
- 시스템 요구사항을 이해하고 이에 맞는 소프트웨어 및 IT인프라 기획/설계가 가능한 자
- 컴퓨터, 전기전자/통신, 수학/통계/산업공학, 물리/기계 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공 지식 보유자

Pluses

- 프로그래밍 언어(C/C++/C#/Python/Java 등) 및 알고리즘 문제 해결 역량 보유자
- 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 활용한 프로젝트 수행 경험 보유자
- 보안관리 및 거버넌스, 통신보안, 표준화 데이터베이스, 인터넷보안 관련 경험 보유자
- 해외 법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유자
- 운영체제(Windows/Linux) 및 Embedded시스템, ARM Architecture역량 보유자
- 직무와 연관된 경험 보유자(프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)

- IT 인프라/서비스 설계 및 개발을 통해 Autonomous Factory 분야 전문가로 성장할 수 있습니다.
- Data 및 신기술(AI, ML 등)을 바탕으로 연구 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.

AI센터 (AI Center)

- 직무: S/W 개발
- 근무지: 경기도 기흥, 화성, 평택, 충청남도 천안, 온양

S/W 기술에 대한 전문 지식을 바탕으로, DS부문 반도체 생산 관련 시스템을 개발하고 S/W 개발 문화를 개선하며 품질을 향상시키는 직무

- Autonomous Factory 향 S/W 개발
 - 생산시스템 개발/운영 및 이상 감지/분석 지능화 시스템 개발/운영
 - 반도체 설비 실시간 공정제어 및 수율/품질 분석 시스템 개발/운영
 - 반도체 수율/품질/생산성 향상을 위한 Scheduling 개발
 - 반도체 생산 자율/예측 의사 결정 모델링 및 Virtual Fab Simulation 개발
 - 생산 Data 거버넌스 기획/운영 및 Data Architect
 - SRE(Site Reliability Engineering) 솔루션 개발/운영
 - 반도체 환경안전/Infra 자동화 시스템 개발/운영 (이상 감지/설비 I/F/영상 모니터링)
- Digital Twin 기반의 Automation System 설계/개발
 - Digital Twin을 통한 실시간 모니터링 및 이상 감지 시스템 개발/운영
 - 반송 로직, 알고리즘 제어 지능화 개발 및 적용을 통한 물류 반송 최적화
 - Autonomous Mobile Robot 제어 시스템 개발/운영
 - 물류 Simulator 및 제어 Parameter 최적화 설계/개발
 - SRE(Site Reliability Engineering) 솔루션 개발/운영
 - 반송/로봇 HW 진단 시스템 개발/운영 및 CAE 해석 기반 Solution 제공

• Information Strategy S/W 개발

- 전사 관점의 업무 프로세스-IT시스템-Data구조-IT기술 아키텍처 설계 및 최적화
- 업무 프로세스 기반 IT 시스템 설계 및 개발
- 데이터 기준 정보 구조화/표준화 및 변화관리
- IT 시스템 거버넌스를 위한 데이터 수집/가공 자동화
- AI Pilot 프로그램 설계 및 지원
- Gen.Al 정량/정성 평가
- AI 서비스 수준 데이터 분석 및 진단 체계 구축
- Web 기반 개발 라이브러리 및 디자인 시스템 구축 및 운영

Data/DevOps/Knowledge Service 개발/구축/운영

- AI/ML/DL 모델을 활용한 서비스, 검색, 챗봇, Q&A 등 사내 서비스 인프라 개발/구축/운영
- 학습용 Data 전처리 및 Data Pipeline 개발/구축/운영
- DevOps/협업 Tool 구축/운영 및 Build/CI/CD 인프라 개발/구축/운영
- Data Platform/Data Lake/DW 및 Data IT Infra 개발/구축/운영
- Self-Analytics 도구, 데이터 병렬 분산 처리 도구 및 DBaaS 개발/구축/운영
- Data Governance(운영/보안/메타데이터/표준화/품질/기준정보) 및 Governance System 개발/구축/운영
- 개념/논리 Data Modeling 및 대용량 Data Processing System 개발/구축/운영

• IT Infra Structure 개발

- Hybrid Cloud Platform 구축/운영/관리 S/W 개발
- Hyper-Scale Cloud Infra 운영 자동화 S/W(Infrastructure as Code) 개발
- Kubernetes 기반 Cloud Native 서비스 운영 S/W 개발
- Cloud Web Service Portal 개발(Frontend/Backend)
- 대규모 Workload의 처리를 위한 고성능 Batch Scheduler S/W 개발

• MIS(Management Information System) S/W 개발

- ERP, PLM, CRM, SCM, SRM, EHS 등 분야별 업무 프로세스 분석/취약점 진단 및 IT시스템 Solution 제공(PI Consulting. Process Innovation)
- MIS Application/Architecture 및 HW/SW 관리/운영/개선/개발(SM. System Management)
- Web(Front/Back-end)/Mobile(Android, iOS) Platform을 활용한 시스템 개발/운영
- RPA/Chatbot/Spotfire/Splunk/BI Solution 활용한 시스템 개발
- Low-code Platform(Mendix, APEX) 및 SaaS 솔루션 활용한 시스템 개발/운영
- MIS Data 분석 환경/체계(경영Data Mart, Data Pipeline, Metadata) 개발/시각화/운영
- MIS Test 자동화 개발

• S/W Platform 개발

- 제품 S/W의 진단, 개선 및 차세대 Platform 개발
- 개발자 생산성 향상을 위한 Code Search / Code Review 자동화 서비스 확산 및 고도화
- AI기반 S/W개발 지원 도구(Coding Assistant) 개선 및 AIOps 체계 구축
- DS부문 제품(메모리, SOC) 보안 취약점 분석 및 보안성 강화
- IT 시스템 보안 취약점 분석 및 DS Infra 보안 선진화
- 외부 보안 취약점 대응 프로세스 구축/운영 및 오픈소스 보안 거버넌스
- DS부문 S/W 코드 리뷰 역량 강화 및 개발자 문화 확산
- S/W 기술 커뮤니티 운영 및 시너지 확대
- Al Inference Engine 개발 및 HBM 기반 Al 가속기 개발 협력

Recommended Subject

• 전산/컴퓨터

컴퓨터구조, 프로그래밍언어, 컴퓨터프로그래밍, 소프트웨어공학, 알고리즘, 운영체제, 데이터베이스. AI 등

• 전기전자(SW)

임베디드시스템, 마이크로프로세서응용, 반도체공학, 데이터구조, 프로그래밍 등

• 산업공학

산업컴퓨팅개론, 산업공학통계, 데이터마이닝, 시뮬레이션, 지능정보공학, 기술경영, 경영체제개론, 서비스공학 등

기계

기계시스템설계, 디지털임베디드시스템, 최적설계 등

물리

전자계측 및 실습, 전산물리 등

• 수학/통계

확률 개념 및 응용, 수리통계, 수치해석, 선형대수학, 이산자료분석, 데이터과학 등

Requirements

- 프로그래밍 언어(C/C++/C#/Python/Java 등) 및 알고리즘 문제해결 역량 보유자
- Embedded시스템 및 ARM Architecture, 운영체제(Windows/Linux) 역량 보유자
- 요구사항을 이해하고 이에 맞는 소프트웨어를 설계 및 구현할 수 있는 역량 보유자

Pluses

- 웹 시스템 개발을 위한 Front-end / Back-end 경험 보유자
- Database에 대한 이해와 활용 경험 보유자
- Al 및 Machine Learning에 대한 이해와 활용 경험 보유자
- ML/DL 기반 최적화, 예측 Model/Application 개발 경험
- 직무와 연관된 경험 보유자 (프로젝트, 논문, 특허, 경진대회)
- CSTS, ISTQB 등 SW Testing Certificate 보유자
- S/W Architecture 및 Source 코드 분석 경험자
- S/W Measurement 기법 활용 및 Metrics 분석 경험자

- 다양한 분석 Platform 및 AI센터 자체 S/W Tool을 개발하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 반도체 분야 S/W 품질 및 생산성 개선을 통해 S/W 전문가로 성장할 수 있습니다.

AI센터 (AI Center)

- 직무:기구개발
- 근무지: 경기도 기흥, 화성, 평택, 충청남도 천안, 온양

설비/인프라/물류시스템의 모니터링 및 제어를 통해 최적의 반도체 FAB 인프라를 구현하고, 기계 공학적 지식을 바탕으로 반도체 신규 라인 셋업 및 안정적인 운영을 담당하는 직무

- Autonomous Factory 구축 및 운영
 - 신규 라인 기획/Setup 및 안정화를 통한 시스템 기반 체계 구축
 - 설비/공정 품질 개선을 위한 Facility 감시/제어 시스템 구축 및 운영
 - 설비 생산성 향상을 위한 분석/제어 시스템 구축 및 운영
 - Safety 환경안전 & FAB Utility 관련 시스템 모니터링 운영
 - Infra 통합 관제 및 제어 시스템 구축 및 운영
- Digital Twin 기반의 Automation System 관리/운영
 - 신규 라인 기획/Setup 및 안정화를 통한 물류 시스템 기반 체계 구축
 - 물류 저장/반송 System Setup/품질 관리 및 운영
 - 고장 진단 기술을 활용한 예지 보전 체계 구축 및 관리

Recommended Subject

• 전기전자(HW)

통신이론, 네트워크 설계, 데이터구조, 프로그래밍 등

기계

진동학, 동역학, 기계제품설계, 시스템제어이론, 기계설계학, 기계시스템 설계 열역학, 열전달, 유체역학, 공조/냉동 등

• 전산/컴퓨터

컴퓨터구조, 프로그래밍언어, 컴퓨터프로그래밍, 소프트웨어공학, 알고리즘, 운영체제, 데이터분석, 데이터마이닝 등

• 산업공학

데이터관리와 분석, 프로그래밍언어, 실험계획법, 정보산업공학, SCM, 경영과학, 경영전략, 프로젝트관리, 품질경영, 경영정보시스템 등

Requirements

- 기계, 전기전자, 열/유체, 통신, 물리 계열 전공자 또는 이에 상응하는 전공지식 보유자
- 인프라 관련 시스템의 유지/보수를 위한 설계 운영 역량 보유자

Pluses

- 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
- 해외 법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어(영어, 중국어) 회화 역량 보유

- 최적의 반도체 FAB 인프라를 구현하는 역량을 배양할 수 있습니다.
- 신규라인의 셋업 및 안정적 운영을 통해 인프라 분야의 전문가로 성장할 수 있습니다.